



WORLD BEST PRODUCTS
BEYOND KOREA & BE THE GLOBAL NO.1

TAESUNG

Investor Relations 2025



Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에 정보제공을 목적으로 (주)태성(이하 "회사")에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려 드리는 바입니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 별도 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며,본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사, 자문역 또는 Representative들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다 (과실 및 기타의 경우 포함). 또한 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

CONTENTS

01

Business Overview

- 01. Corporate Identity
- 02. 사업부별 로드맵



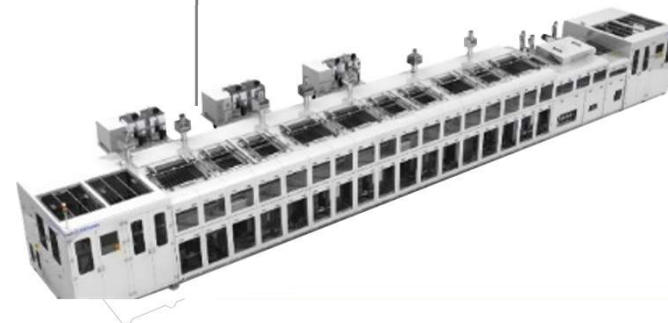
02

Business Strategy

- 01. 복합동박 장비 (1)시장현황
(2)핵심 경쟁력
- 02. Glass 기판 장비 (1)핵심 경쟁력
(2)주요 전략
- 03. 신공장 증설

Appendix

- 01. 실적 현황
- 02. 연결재무제표
- 03. 회사 개요
- 04. 성장 연혁
- 05. R&D 현황





WORLD BEST PRODUCTS
BEYOND KOREA
& BE THE GLOBAL NO.1

Business Overview

- 01. Corporate Identity
- 02. 사업부별 로드맵



01 Corporate Identity

차세대 반도체 · 2차전지 첨단 장비 전문 기업



사업영역



※ 주1: RTR: Roll-to-Roll

02 사업부별 로드맵

신규 사업 확대를 통한 외형 성장 도모

복합동박 장비

배터리 경량화, 원가절감, 안정성 확보의 핵심인 복합동박 장비 개발 및 공급

데모장비 제작/시연회
진행/고객사샘플 공급

국내외 고객사 수주계약

시제품 제작 → 장비 양산 라인 구축 → 생산 본격화

2024

2025

2026

2027

Glass기판 장비

Glass기판 시장 본격화에 따라 국내외 반도체 기판 Key Player들과 접촉 중

데모장비
개발 완료

초기
Glass기판
시장 진입

주요 반도체 기판 업체 수주계약

시제품 제작 → 장비 양산 라인 공급 → 생산 본격화

2024

2025

2026

2027

중국 주요 EV 업체



국내 배터리 업체



주요 반도체 기업





WORLD BEST PRODUCTS
BEYOND KOREA
& BE THE GLOBAL NO.1

Business Strategy

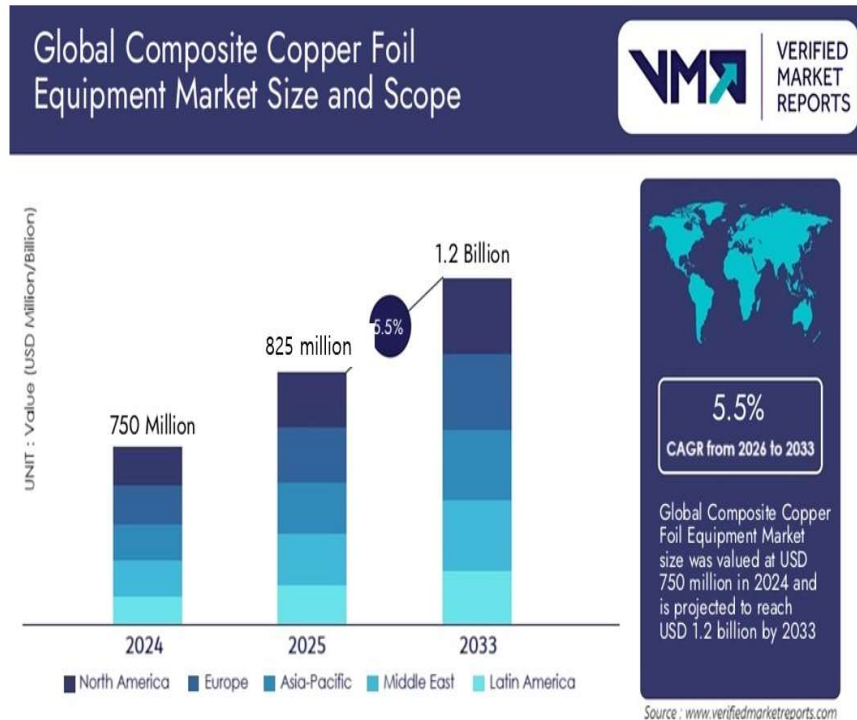
- 01. 복합동박 장비 (1) 시장 및 경쟁사
 (2) 핵심 경쟁력
- 02. Glass 기판 장비 (1) 핵심 경쟁력
 (2) 주요 전략
- 03. 신공장 증설



01 복합동박 장비 (1) 시장 현황

복합동박 제조 장비 시장 고성장세 시현하며 수요 급증

글로벌 복합동박 시장 전망



- 복합 동박 장비 시장 규모는 2024년 7억 5천만달러로 평가되었으며, 2033년까지 12억 달러에 도달할 것으로 예상
- 2026년부터 2033년까지 5.5% CAGR

복합동박 제조 업체 현황

주요 제조사	생산 능력 및 규모
BAOMING Technology	100 million m ² /year 계획
Nanopore	복합동박 양산 / 추가 Capa 증설 중
Rouzhen	복합 알박 양산 / 복합동박 양산 구축 진행 중
Huaqing	복합 알박 & 동박 양산 / 추가 Capa 증설 계획
Enpack	복합동박 양산 및 추가 500 mil m ² /year 생산 Capa 증설 중
Nuode New Materials	Pilot / R&D lines , 50 million m ² /year
Hailiang Group	R&D line 보유
Wason New Materials	30,000 tons 전해동박 생산 규모 보유, 복합동박 계획 검토 중
Wanshun New Material	80,000 tons 전해 동박 생산 규모 보유, 복합동박 계획 검토 중
Taesung	국내유일 1세대 양산 장비, 샘플 대응중 장폭/속도 개선 2세대 장비 개발 완료

중국

- 리튬 전지용 복합동박 제품 생산 및 개발 단계
- 복합동박의 양산 가능 장비 및 기술 개발 단계
- 전체적으로 중국 중심의 복합기재 양산 / 개발이 진행중인 상황

01 복합동박 소재 (1) 시장 현황

복합동박 소재 시장 고성장세 시현하며 수요 급증

글로벌 복합동박 소재 시장 전망

✓ 복합동박 시장은 2023년부터 2031년까지 약 71%의 CAGR로 성장 예상 * CAGR : Compound Annual Growth Rate



※ 출처: valuates report

01 복합동박 장비 (2) 핵심 경쟁력

핵심 도금 기술력 기반으로 차세대 복합동박 장비 경쟁력 확보

RTR 수평 동도금 장비



장비 경쟁력

- 1 국내최초 RTR 인라인 방식으로 수율 안정화
- 2 복합동박 도금 기술력 보유
- 3 10m/s 이상의 스피드로 생산성 향상
- 4 다양한 사이즈 동박 생산 가능

타사대비 강점

태성 - RTR 방식

- 외곽부위까지 제품으로 구현하여 수율 상승
- 폭변경이 가능하여 제품 Size에 제약이 없음
- 자동 개별 텐션 제어가 가능하여 균일도 향상

Vs.

타사 - Clamping 방식

- 외곽부 도금편차 구간 발생으로 수율 저하
- 정해진 규격만 생산가능 - 유연한 제품 대응 불가
- 일괄 텐션제어로 균일도 저하

※ 참고자료

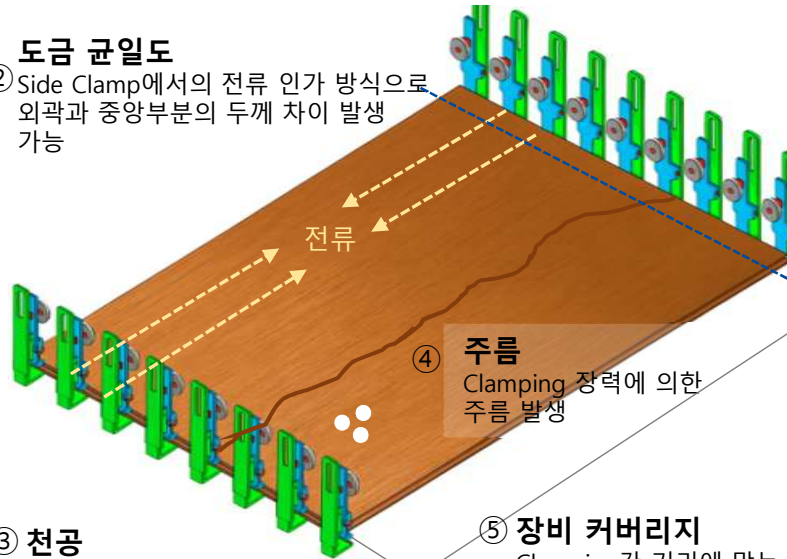
Clamping 방식 (타사)

① 제품 수율

Clamping 자국 or Burning 발생한 양쪽 사이드에 대해
과다 Slitting 필요 (100~150mm 수준)

② 도금 균일도

Side Clamp에서의 전류 인가 방식으로
외곽과 중앙부분의 두께 차이 발생
가능



④ 주름

Clamping 장력에 의한
주름 발생

③ 천공

Clamping된 부분과 안된 부분의
필름장력에 의한 천공 발생 가능

Clamping 장비 이미지



RTR(롤투롤) 방식 (당사)

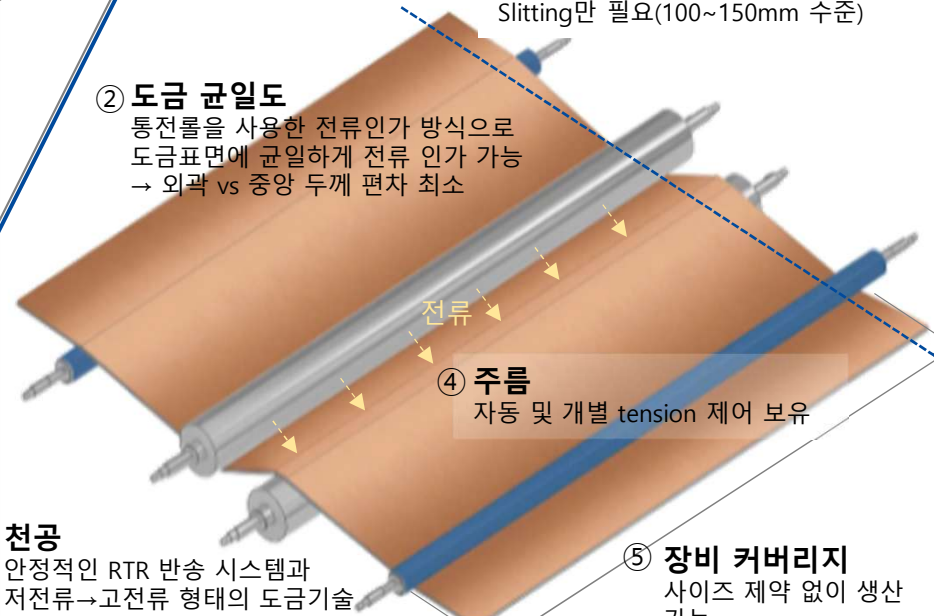


① 제품 수율

RTR방식 적용을 통해 Curl 제거수준의
Slitting만 필요(100~150mm 수준)

② 도금 균일도

통전롤을 사용한 전류인가 방식으로
도금표면에 균일하게 전류 인가 가능
→ 외곽 vs 중앙 두께 편차 최소화



④ 주름

자동 및 개별 tension 제어 보유

③ 천공

안정적인 RTR 반송 시스템과
저전류→고전류 형태의 도금기술

⑤ 장비 커버리지

사이즈 제약 없이 생산
가능

※ 참고자료

2차전지 사업부 3개년 계획

구분	2025(E)	2026(E)	2027(E)
핵심 목표	장비 : 시장 Promotion / 진입 소재 : 소량 생산 → 전지 적용 Test	장비 : 시장 진입 / 확대 소재 : 1GWh 생산 구축 (5백만 m ²)	장비 : Global 시장으로의 확대 소재 : 5GWh 생산 구축 (36백만 m ²)
주요 고객사 Location	중국 / 한국 / 캐나다 등	중국 / 한국 / 캐나다 / 일본 등	중국 / 한국 / 캐나다 / 일본 / 유럽 / 미국 등
추진 전략	✓ 장폭/길이 생산 기술 확보 -Proto Type: Version-up ✓ Film 원소재 확보 (업체 선정) 전지 적용 특성 확보 ✓ 소재에 대해 고객사와 Cell level validation process 구축	✓ Inter-Battery등 전시회 참여 - 수주 확보 활동 ✓ 박막 필름 구동 검증 (현 수준 4.5um → Target 3.5um) ✓ 소재 생산용 신공장 -Sputtering 장비 적용 → 소재 특성 개선 * 개선 소재 전지 특성 확보 ✓ 전고체 배터리를 Ni도금 및 Bipolar 소재 개발 ✓ 전지박용 이외의 소재 시장 진입 (EMI Shield, Coil 등)	✓ 박막 필름 도금 장비 개발 (현 수준 6.5um → Target 5um이하) - 고객 Needs 적극 대응 ✓ 고기능 Film 개발 - 신규 소재 전지 특성 확보 (저저항/난연성 등)

02 Glass기판 장비 (1) 핵심 경쟁력 ①

기존 사업 경쟁력 바탕으로 Glass기판 시장 선도

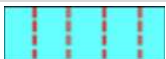
국내 Glass기판 밸류체인 예상도



02 Glass기판 장비 (1) 핵심 경쟁력 ②

TGV 핵심 공정 장비 기술 개발 완료 - 12개 공정 적용 가능, 5개 공정 추가 개발 중

■ 당사 적용가능
■ 당사 개발 중

TGV 공정 흐름	이미지 및 개발여부
01. Initial cleaning	 (1) 적용가능 (5° Tilt 타입)
02. Laser modification	
03. Cleaning after laser modification	 (2) 적용가능 (5° Tilt 타입)
04. Glass hole etching	 (3) 적용가능 (Dip 타입)
05. Glass slimming & cavity etching	 (4) 적용가능 (Dip 타입)
06. Cleaning after glass etching	 (5) 적용가능 (5° Tilt 타입)
07. Glass crack inspection	
08. Electroless copper plating	 (13) 개발 중 (Dip 타입)
09. Cu via fill plating	 (14) 개발 중 (Dip 타입)
10. Cu half etching	 (6) 적용가능 (5° Tilt 타입)
11. Chemical Mechanical polishing	
12. Seed layer electroless copper plating	 (15) 개발 중 (Dip 타입)

TGV 공정 흐름	이미지 및 개발여부
13. Seed electro Cu plating	 (16) 개발 중 (Dip 타입)
14. Dry film lamination pretreatment	 (7) 적용가능 (5° Tilt 타입)
15. Dry film lamination	
16. Auto peeling	
17. Dry film LDI exposure	
18. Dry film developing	 (8) 적용가능 (Vertical 타입)
19. Electro Cu pattern plating	 (17) 개발 중 (Dip 타입)
20. Dry film stripping	 (9) 적용가능 (Vertical 타입)
21. Seed electro Cu flash etching	 (10) 적용가능 (Vertical 타입)
22. ABF CZ pretreatment	 (11) 적용가능 (5° Tilt 타입)
23. ABF lamination	
24. After-treatment Singulation Glass Core Substrate	 (12) 적용가능 (5° Tilt 타입)

02 Glass기판 장비 (1) 핵심 경쟁력 ③

TGV Wet 장비 개발에 있어 다양한 강점 보유

01

TGV세정 및 에칭기 판매 실적 보유 /
GCS용 수직현상·에칭기 장비
Demo 장비 보유

- Cu Plating Line 개발로 Glass Interposer
& GCS Total Wet Solution 제공

02

Crack 최소화 장비: 고객
주문 대응형 장비 제작

- 가벼운 샤프트
- 자석사용 진동 최소화(헬리컬 기어대비)
- 제전디스톨 및 어스로 이물최소화
- 자석 구동으로 완전밀폐하여 크린룸 내
가스발생 / 이물 유입차단

TGV^{주1} Wet 장비 개발
장점

Glass Interposer &
GCS^{주2} Total Wet
Equipment Solution
제공

※ 주1 TGV: Through Glass Via
※ 주2 GCS: Glass Core Substrate

03

박판 대응용 JIG 제작기술 보유
(JIG특허)

04

구간반복으로
공간 및 제작비용 최소화

05

자동화 솔루션:
메거진 / 자동로딩 & 언로딩

06

TGV Sample 제작용 장비 보유
(시제품 테스트 용이)

07

해외(중국, 베트남) AS 및
장비제작 능력 보유

02 Glass기판 장비 (1) 핵심 경쟁력 ④

신규 시장 진출을 위한 핵심 경쟁력 기보유

Glass기판 장비 시장 선점을 위한 핵심 경쟁력 확보

영업망 국내 대기업을 포함한 50여개 고객사 포트폴리오 확보	양산능력 국내 PCB Big3 식각, 박리, 현상 장비 전체 공급 중
기술력 10건이상의 Glass기판 특허 등록 및 추가 특허 출원 진행 중	노하우 업력 25년의 인력구성으로 업계 최고수준 노하우 보유

Glass 기판 장비에 관한 특허 출원 현황 (국내 및 해외)

특허 종류	
비접촉 반송 방식	메거진 수취시 Scratch 방지
비접촉 Oscillation	Glass Damage 최소화 반송 구조
반송 Yawing방지	안정화된 Handling Slim Jig
수세부 경사변환 방식	양면 Etching
Dry Unit 구동 접지	Shaft 가공 기술

Glass기판 장비

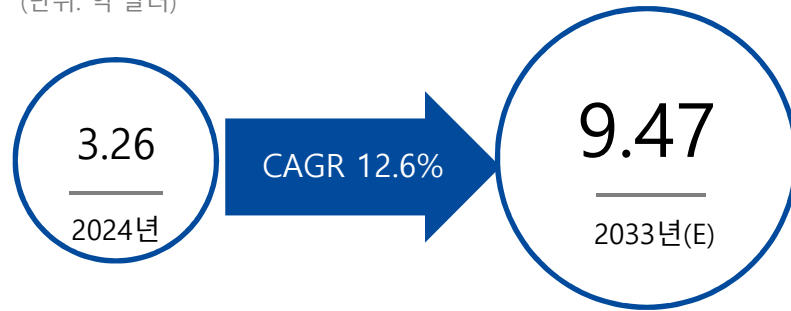


02 Glass기판 장비 (2) 주요 전략

TGV 에칭장비 공급을 통한 신뢰성 확보 → 국내외 주요 고객사 선점

TGV Glass 기판 시장 전망(GCS+Interposer)

(단위: 억 달러)



Glass기판 양산 계획



- 2030년 이전 상용화 목표로 10억달러 투자



- 외부 공급망 구축 위한 샘플 테스트 진행 중, '26년 시생산 예정, '28년 적용 목표



- 미국 자회사 애플릭스 조지아에 공장 설립 '26년 시제품 양산, '27년 대량생산 목표



- 반도체 유리기판 직접 진행을 위해 일본 스미토모 화학과 JV를 통한 시장 진입



- '24년 2월 사업진출 공식화, 공급망 구축 중 '25년 말 시생산 목표

※ 출처: 보도자료 및 각 사 발표자료

Glass기판 장비 단계별 전략

1단계 TGV 에칭 장비 Pilot line 공급 → 초기 양산 전환

- 국내 J사 2차 수주 기반 레퍼런스 확보
- 국내 Fabless·OSAT^{주1} 대상 Sample line 확대
- 천안 제2공장 양산 체계화 준비



2단계 Glass Interposer 수요 본격화 대응

- 국내 고객사 추가 확보 및 양산화 전환
- 중대형 유리기판 대응 Wet 에칭 장비 개발 완료



3단계 글로벌 수출 및 제품라인업 다변화

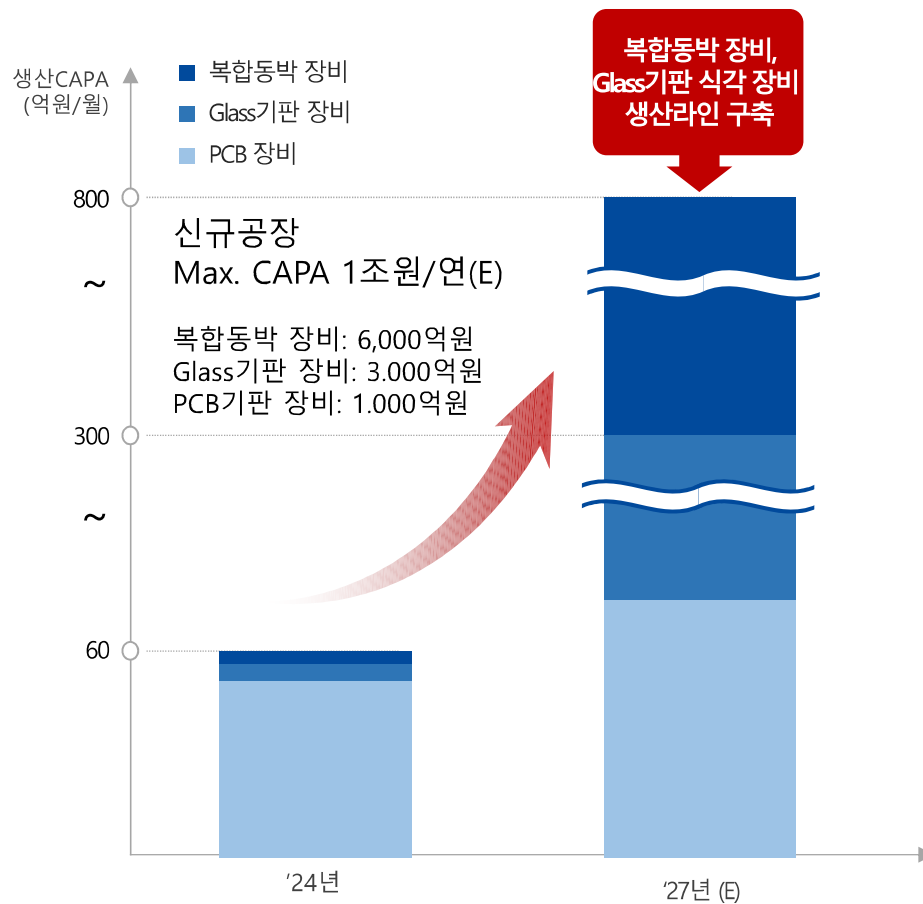
- 대만, 중국, 일본 등 고객사 다변화
- RF, AiP, Optical SiP 전용 Etch 세정 통합 장비 출시
- 고객 맞춤형 Dry/Wet Hybrid 대응으로 고부가 수익 구조 확보

※ 주1: OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test), 반도체 후공정 서비스기업 16

03 신공장 증설

증설을 통한 생산사이트 확보로 복합동박 및 Glass기판 장비 사업 본격화

CAPA 증설



공장 개요



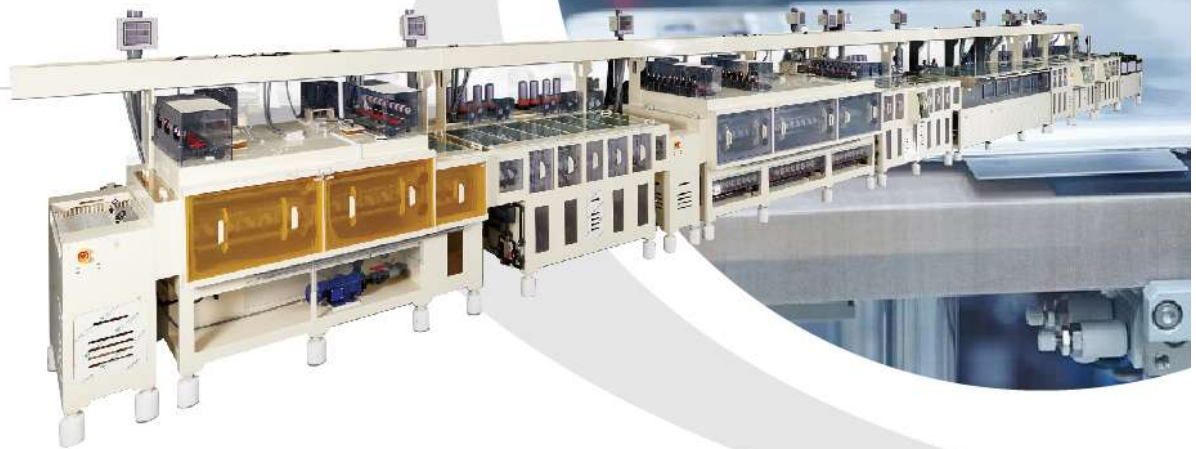
공장명	• 태성 천안 신공장
공장위치	• 천안 북부 BIT 일반 산업 단지 내
부지면적	• 부지 10,000평, 연면적 17,000평
진행 계획	• 25년 1분기 착공 • 26년 6월 준공 후 본사 이전, 공급 본격화 • 복합동박 RTR 도금 장비, Glass기판 장비 생산 거점



WORLD BEST PRODUCTS
BEYOND KOREA
& BE THE GLOBAL NO.1

Appendix

- 01. 실적 현황
- 02. 연결재무제표
- 03. 회사 개요
- 04. 성장 연혁
- 05. R&D 현황



01 실적 현황

고부가가치 신규장비 수주 확대로 장기적 성장 목표

연결기준 실적

(단위: 백만원)

구 분	2024.1H	2025.1H	YoY(%)	2023	2024	YoY(%)
매 출 액	32,295	16,187	-49.9	33,339	59,212	+77.6
매 출 원 가	23,054	14,499	-37.1	28,125	44,653	+58.8
매출총이익	9,241	1,688	-81.7	5,214	14,559	+179.2
판 관 비	4,462	4,429	-0.7	5,900	8,522	+44.4
영 업 이 익	4,780	(2,741)	적자전환	(686)	6,038	흑자전환
영업이익률(%)	14.8	-	-	-	10.2	-
당기순이익	3,659	(2,064)	적자전환	(1,417)	5,968	흑자전환

Financial Highlights

매출액

- 25.1Q 트럼프 정부 관세 부과로 인한 불확실성 증대로 전방고객사 투자 시점 지연
- 25년 하반기부터 투자 확대 예상, 적극적인 마케팅 활동으로 매출 증가 기대

영업이익

- '24년 매출 회복하며 영업이익 및 당기순이익 흑자 전환
- '25.1H 매출 감소, 고정비 효과로 영업 적자
- 한국은 복합동박, 글라스기판 등 고부가가치 제품 개발/제조 중심
- 일반 양산 장비는 중국 자회사로 이관 → 영업이익률 상승 예상

02 연결재무제표

요약 연결재무상태표

(단위: 백만원)

구분	2022	2023	2024	2025.1H
유동자산	33,020	31,142	33,588	99,997
비유동자산	22,815	25,834	46,026	63,898
자산총계	55,834	56,976	79,614	163,895
유동부채	22,165	24,878	22,130	19,275
비유동부채	1,275	1,208	16,502	16,494
부채총계	23,441	26,085	38,632	35,769
자본금	2,524	2,524	2,589	3,050
자본잉여금	23,087	23,087	26,605	115,749
기타포괄손익누계	1,209	1,092	1,489	1,170
이익잉여금	5,621	4,205	10,173	8,109
자본총계	32,394	30,890	40,982	128,126

※ 출처: 사업보고서 기준

요약 연결손익계산서

(단위: 백만원)

구분	2022	2023	2024	2025.1H
매출액	61,248	33,339	59,121	16,187
매출원가	50,560	28,125	44,653	14,499
매출총이익	10,688	5,214	14,559	1,688
판매비와 관리비	8,374	5,900	8,522	4,429
영업이익	2,314	(686)	6,038	(2,741)
기타이익	297	60	179	130
기타손실	2,819	590	41	144
금융수익	1,710	644	1,432	889
금융원가	991	640	544	395
법인세비용 차감 전 순이익	511	(1,210)	7,064	(2,262)
법인세비용	968	206	1,095	(198)
당기순이익	(457)	(1,417)	5,968	(2,064)

※ 출처: 사업보고서 기준

03 회사 개요

일반 현황

회사명		(주) 태성
대표이사		김종학 (金鍾學)
설립일		2006년 6월 법인설립 (2000년 8월 태성엔지니어링 창업)
자본금		30.5억원 (액면가 100원)
주요사업		PCB, 유리기판 장비 및 이차전비 복합동박 장비
사업장	한국 본사	경기도 안산시 단원구 해안로 228
		종업원수: 135명
	해외 법인	태성(주해)과기유한공사 (중국 광둥성 동관시)
		태성아시아 (베트남 하노이 빈푹성)
R&D		총 28명: 부설연구소 7명, 설계/시스템개발 21명

※ 2025년 6월 기준

CEO Profile

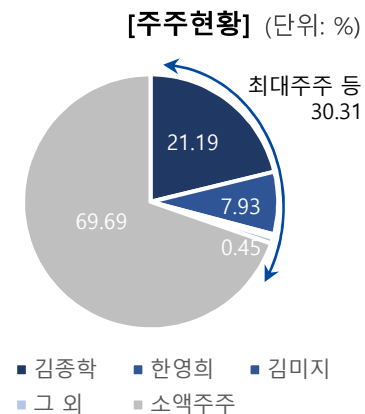


TAESUNG

김 종 학 대표이사 사장

- 일진그룹 엔지니어
- 에덴기계 공장장
- 태성엔지니어링 대표
- 現 (주)태성 대표이사

(기준일: 2025.09.30)



구분	주주명	주식 수 (주)	지분율 (%)
최대 주주 등	김 종 학	6,463,402	21.19
	한 영 희	2,418,499	7.93
	김 미 지	136,707	0.45
	그 외	226,676	0.74
	소 계	9,018,608	30.31
소액주주	-	21,255,446	64.79
	합 계	30,500,730	100.00

04 성장 연혁

내수 중심에서 수출 중심으로 PCB에서 복합동박으로 확장 → 글로벌 기업으로 도약

창립기

2000년~2005년

PCB장비 국산화 선도

- (00) 태성엔지니어링 창업
- (01) PCB 정면기, 동분여과기 개발
- (03) 중국 수출 개시/ Foxconn 社
중국 상하이 대리점 설립
- (04) FPCB 정면기 개발 및 상용화
- (05) 전자신문주관 올해의 히트상품
중국 수출 본격화/ZDT 外

기반조성기

2006년~2010년

제품라인 확대

- (06) (주)태성 법인설립 (2.5억)
- (08) 박판형 JET SCRUBBER 개발
PCB 습식 장비 생산 출하 개시
- (09) 세라믹브러시 해외 수출-중국/대만
일본 수출 개시/ 메이코 社
일본 수출 본격화/ 이비덴 社
- (10) 정면기 부문 → 세계일류상품선정
무역수출 100만불탑 수상

성장기

2011년~2015년

수출 확대 및 해외거점 확보

- (11) 무역수출 300만불탑 수상
- (13) 무역수출 500만불탑 수상
동관태성(중국) 법인 설립
- (14) 진공 이류체 DES 양산
- (15) 무역수출 1,000만불탑 수상
대통령 산업포장 수상

도약기

2016년~2025년

해외 거점 확대로 성장 본격화

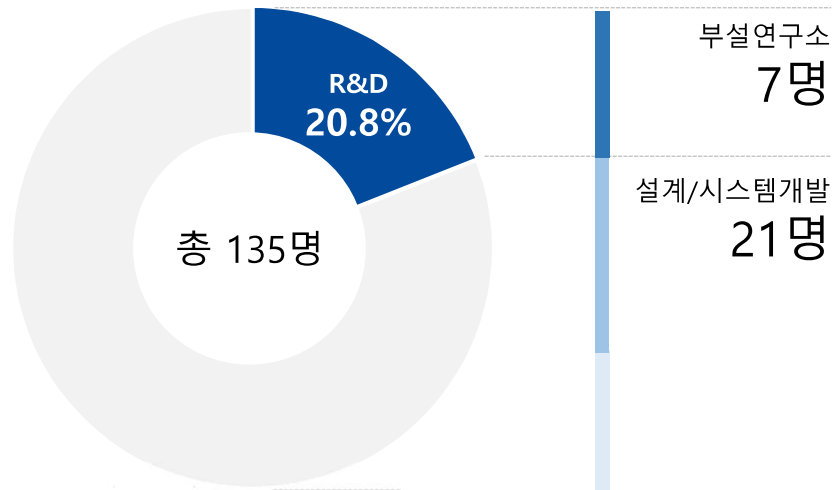
- (18) 태성아시아(베트남) 법인 설립
- (20) 소재·부품·장비 전문기업인증
- (22) 코스닥 상장 (SPAC합병)
무역수출 3,000만불탑 수상
- (23) 주해태성(중국)법인 설립
- (24) 복합동박 데모장비 시연
- (24) 글래스기판 장비 데모 시연
- (25) 천안신공장 착공, 유상증자 900억 납입



05 R&D 현황

연구개발 인프라를 기반으로 지속적인 투자와 신제품 개발 집중

R&D 인력현황



**파트별 총 28명의
연구개발 전문인력 보유**
(R&D연구소 외 시스템개발 인력 포함)

특허 등록 / 출원 현황

특허 등록 현황	
1	기판이송장치
2	매칭액 공급구조체
3	인쇄회로기판의 에칭방법 및 에칭장치
4	인쇄회로기판의 습식 에칭 공정에서 기판 위의 퍼들링 제거를 위한 흡입 롤러 장치
	...
28	기판의 산화방지장치
29	수평 이송방식의 2차전지용 음극재 도금장치 및 그 도금방법
30	2차 전지용 필름 처리 시스템

국내외 특허 등록 30건 / 특허 출원 14건

국책과제 수행 현황

연구과제명	
1	PCB정면 처리용 초박판 정면기 개발 (기술혁신개발사업)
2	진공 및 이류체 적용한 초미세회로 PCB용 Subtractive Wet Etch System 개발 (수출기업개발사업)
3	PCB 0.06t 이하 제품 생산을 위한 Sheet/ Roll to Roll 정면 System 개발 (수출기업개발사업)
4	광폭, 박판의 FPCB 롤투롤 수평 전해등 Pattern Plating System 개발 (수출기업개발사업)
5	반도체 Glass기판용 고수율 Damage-free Etcher(식각장비) 개발

국책과제 수행 5건 완료 (24.9억원 지원)